



拥抱国产化浪潮，夯实智算自主芯片底座

苏州盛科通信股份有限公司
2026年08月07日



三重因素推动 开启国产交换芯片黄金周期

01 | 需求端

AI重构网络架构，信创市场与智算互联并行演进，为交换芯片带来“双轮驱动”式的双重增长曲线

02 | 政策端

自主可控要求转为刚性约束，配套财政补贴落地加速替代

03 | 供给格局

行业供给关系紧张，供应安全尤为重要，具备商用且批量供应能力的高性能芯片，稀缺价值凸显

01 / AI带动网络革新需求

2026年国产超节点商用元年：WAIC 2026厂商集中发布超节点集群，万卡/十万卡智算集群落地，GPU互联瓶颈正在从算力转向网络。

运营商智算交换机开启规模化集采：中国移动启动2026-2027年度RoCE交换机大规模招标，首次将国产高端400G/800G互联设备纳入规模采购清单，从试点走向上量。

高速端口迭代周期开启：400G端口规模化部署，800G逐步导入商用，1.6T样机产品，单机无论从交换带宽还是端口速率都持续提升。

02 / 市场双驱动

传统信创：智算升级

政企/金融/运营商等信创市场，AI拉动存量的升级替换趋势

新兴智算：高弹性增量

长节点集群低时延互联刚需，打开全新高端市场

全系列超节点UniPoD S80000

1024卡

Scale-up卡间互联

128卡

单柜最高部署规模

70%

训练性能提升

3×

推理性能提升

开放架构：支持1024卡至16384卡规模扩展

多元算力兼容

极致互联，无阻塞通信

分钟级AI应用构建



新华三S80000超节点

对于AI超节点

网络已经不再是“配角”，而是与AI芯片同等重要的算力基础设施
传统信创/新兴智算双驱动，推动行业迎来“量价齐升”的新一轮成长周期

01 / 算力自主刚性要求

算力基建硬指标落地：新建国资及央企智算中心明确国产硬件采购比例红线($\geq 75\%$)，未达标项目直接影响审批流程和专项补贴，政策执行具有强约束性。

财政补贴强化经济性：全国多地出台全栈国产算力建设配套补贴政策，直接降低云厂商与运营商采购成本，通过经济性补贴提升国产网络设备方案的综合性价比与落地动力。

一体化算力网构建要求：“人工智能+”行动明确全国一体化算力网建设目标，底层网络软硬件的自主可控被确立为不可动摇的核心前提。

二级市场核心点：

国产替换不再是短期炒作题材，在供应安全诉求下，金融/能源/运营商等关键信创行业正主动加速国产替换进程，构成政策支撑的可靠供应链



政策指标持续定调自主可控与人工智能发展方向
算力基础设施作为国家战略性资源，
其国产替代已经逐步落实到执行细则和采购清单要求中

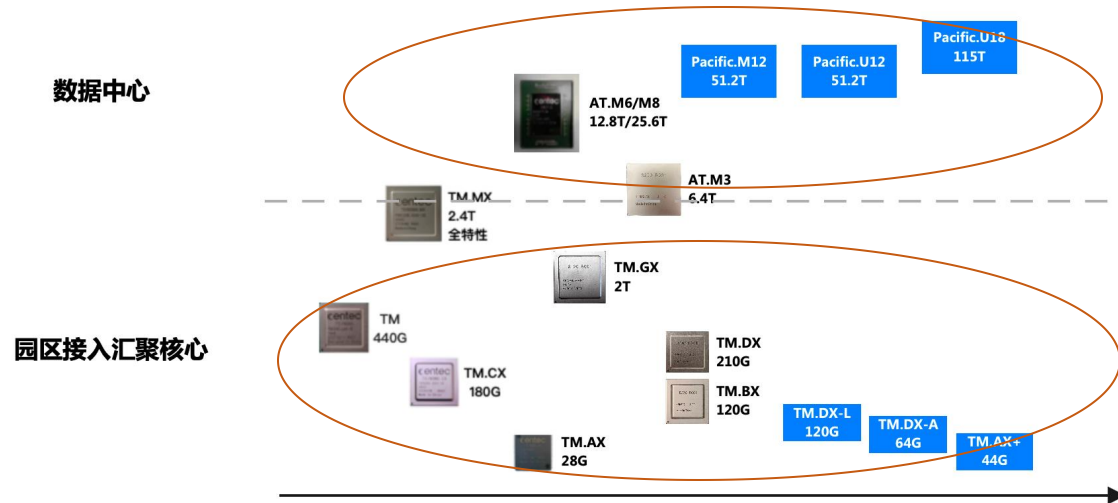
01 / 全球高端芯片供应紧缺

海外巨头供给受限：全球高端交换芯片市场长期由博通等海外厂商垄断，受全球供应链及地缘政治因素影响，其面向AI智算中心等场景的高性能芯片在国内出现供应紧张、交货周期大幅延长的现象（博通策略优先保证北美供应）。值此超节点商用元年，给国内智算发展带来非常严峻的供应链风险。

国内厂商分化，全栈自主芯片解决方案稀缺：国内芯片厂商虽多，但具备全栈芯片方案、充分商用经验以及批量供应能力的国产芯片厂商非常稀缺。

02 / 盛科通信：全栈商用的国产供应商

全栈商用可靠的国产芯片供应能力：在当前供应紧张的环境下，盛科凭借其规模商用的供应经验以及全栈完整芯片解决方案，给客户可提供可商用、保障供应、可持续迭代的芯片方案。



突破面

数据中心第一代智算产品形成基础，批量供应
战略方向：带宽进一步爬升，国内工艺备份

基本面

园区接入/汇聚/核心 全栈商用解决方案，第一代产品大规模供应
战略方向：基于本土工艺全面迭代，多维度需求匹配细分



盛科产品市场

夯实基础，稳步突破，拥抱国产化浪潮

01 | 产品规划

构建覆盖全场景的网络芯片产品矩阵，以技术硬实力满足多层级网络的多元化需求

02 | 行业竞争格局

依靠经过市场验证的芯片设计能力、规模供应保障，盛科作为商用开放芯片厂商，支撑客户方案充分竞争力

03 | 市场表现

关键客户群的持续深耕、智算行业的重点突破与营收规模的稳健增长，充分体现核心技术的成熟度与商业化落地能力

全面有竞争力，可持续的产品矩阵

	量产产品	盛科战略	新一代产品布局
智算互联 互联网云计算	25.6T系列国际主流水平	构建生态 基于本土工艺旗舰产品	51.2T 51.2T 本土工艺 115T
企业网、行业 运营商数据中心	广泛行业应用	成熟产品 本土化裂变	PK228-009-1E 2045 Made in China 2.0T量产 8290-R001 KP8278 J-H0 Made in China 6.4T量产
企业网、行业 接入/汇聚	centec TSINGMA CX 18V092-000-1E 2022 CTCS118 R001 Made in China 广泛接入汇聚应用	成熟产品 本土化裂变	5220 R001 KP852T J-B0 Made in China 5260 R001 KP852T J-A0 Made in China 120G 64G 44G 800G 210G/120G已回片

框式核心

旗舰路由交换机



目标市场

大中型数据中心核心交换机/智算中心

产品优势

高性能，大带宽，速率丰富
智能无损增强

园数融合



目标市场

大中型数据中心/云场景核心交换机

产品优势

成熟稳定
ADDC/Campus/Seer Fabric
覆盖10G至400G

S12500G-AF系列

盒式800G/400G/200G/100G

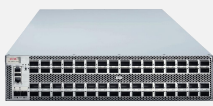
高密400G汇聚设备



S9825-8C-G
16*200G
8*400G
4*800G



S9820-8C-G
16*100G/ 8*200G
4*400G/2*800G



S9825-64DH-G
64*400G
S9855-32DH-G
32*400G

适用场景

400G盒式核心
无损网络Leaf/Spine

产品优势

高性能，端口灵活，速率丰富
纳秒级时延 (700ns)
智能无损增强

100G/200G盒式接入



S9855-24B16DH-G
24*200G+16*400G



S9850-32H-G
32*100G

盒式25G/10G

高密25G/50G



S6850-56HF-G
48*25G+8*100G

适用场景

通用市场/无损网络Leaf

产品优势

智能无损组网主推产品
纳秒级时延 (700ns)
可视化/微分段等能力
全面适配数据中心解决方案

高密10G



S6805-56HF-G
S6805-56HT-G
48*10G(电)+8*100G



竞争格局：秉持开放生态的发心，充分参与竞争



盛科的产业价值是提供开放的网络交换芯片，21年时间形成了广泛的市场和客户基础



海思CPU/GPU/网络全家桶，强有力的封闭生态



盛科构建开放创新的生态体系

完备的产品体系

产品系列化:

从数据中心51.2T, 行业汇聚核心25.6T、12.8T, 延伸至接入2T、440G、120G等, 盛科芯片**全栈覆盖**

解决方案体系化:

接入->汇聚->核心解决方案统一, 提供**端到端**解决方案的底层芯片支撑

ASIC级核心技术

低功耗:

同带宽交换芯片相比NP芯片约低**5%~10%**功耗, 匹配绿色节能需求

性能突出:

不同于NP架构, 盛科ASIC芯片在客户业务场景性能表现突出, 其中**时延性能**优于所有厂商

开放健康的生态

开放的以太体系:

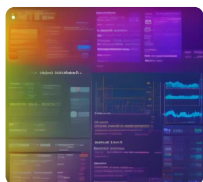
盛科致力于开放架构, 汇聚多元客户需求, 携手生态伙伴构建开放体系, 满足更多厂家的需求

确定的供应体系:

交换芯片作为盛科的主营业务, 持续投入迭代, 保障供应, 成为客户坚实可靠的芯片供应商

AI场景流量画像

(AI-Flow Potrait)



- 适用于AI训练场景
- 其他流量突发性大、流数少场景

硬件建流

硬件建流 **不依赖采样和软件**
short live流和突发流不遗漏

毫秒级刷新

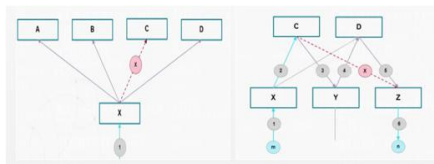
芯片内上百条AI大流毫秒级刷新
10ms全刷新

**高效完成 AI 流量故障
定位与时延分析**

数据面极速自愈

(DPSH)

- ROCE SAN，网络故障存储应用无感知
- AIGC，网络故障极速自愈，AI不断训
- Spine Leaf架构，故障切换性能极高



Without notification

故障时无需通知远端设备切换

us级自愈

极速绕行，微妙级稳定切换性能

**微秒级数据面自愈
网络故障应用无感知**

统一运维

(Unified-Flow Analysis)

UDP流分析

AI流量画像
NET
STREAM
RoCE流分析



IFIT
MOD
DPI UCC
延时监控

场景化组合

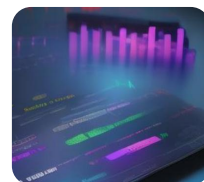
通用场景：ifit+mod+延时监控
通用+RoCE场景：RoCE流分析+AI流量画像
通用场景：叠加UDP流量分析+DPI UCC

**统一运维底座，多场
景一站式可视化运维**

高精度Roce Telemetry

(High-Precision)

- HPC
- AI训练参数网
- 集中式和分布式存储

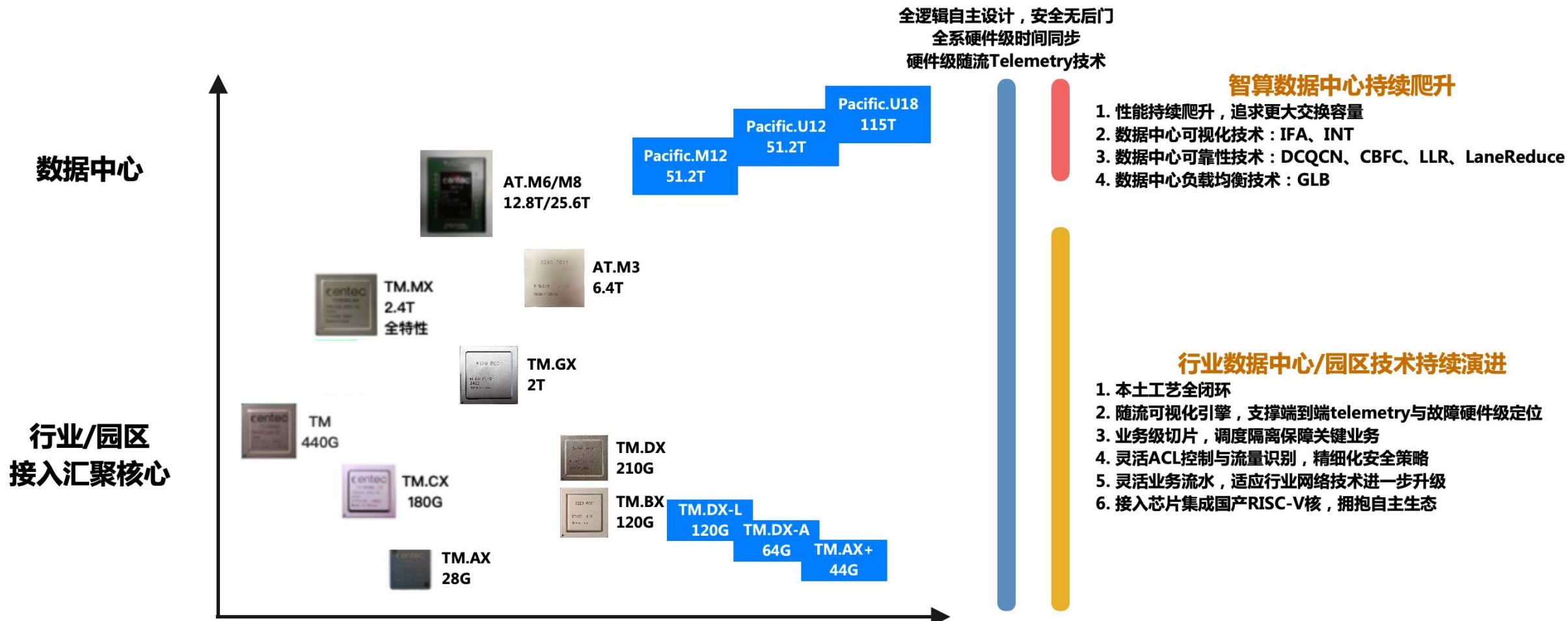


拥塞流实时可视

拥塞趋势实时可视

端口吞吐实时可视

**高精度业务分析
故障实时可视**

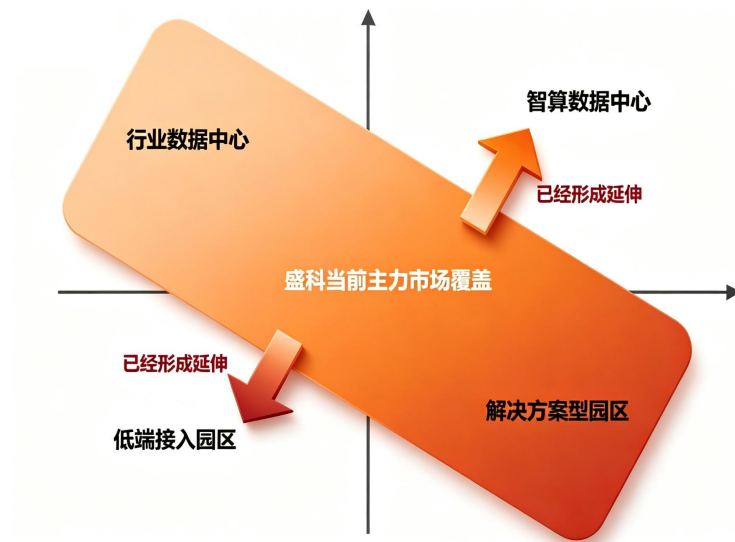
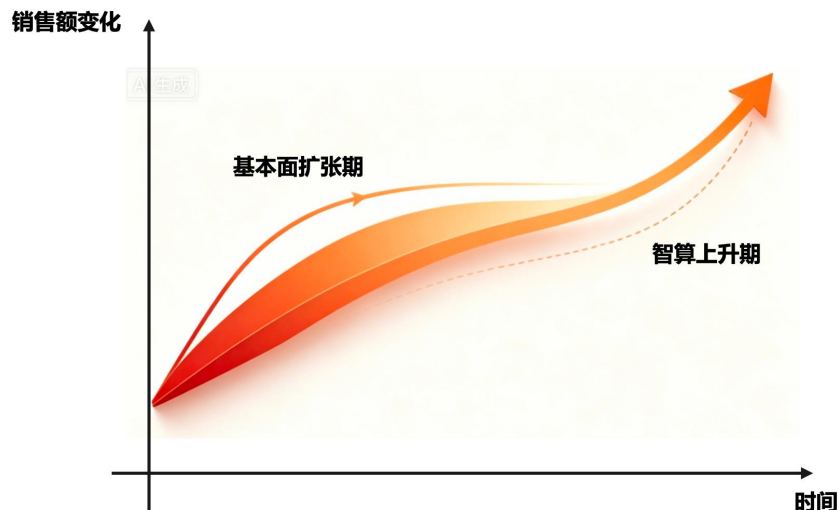


01 / 广泛客户认可，拓展重点场景合作深度

信创行业市场：通过客户软硬件集成，盛科交换芯片园区/行业数据中心方案已经被运营商、金融、政企、电力广泛认可。

智算市场：重点战略方向，提升重点场景合作深度。盛科与设备厂商配合，在部分智算互联网/运营商已经形成项目导入，作为国产芯片方案开展测试验证。

园区低端下沉：匹配盛科低端产品规划，持续延伸重点客户合作深度，配合客户软件特性，形成全栈式交换解决方案。

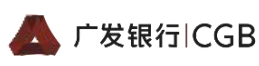


盛科销售规模持续上升
随战略，从基本面市场扩张期 向 智算上升期过渡
凸显盛科商业落地、规模供应能力

证券、交易所



银行、保险





盛科交换芯片

**夯实基础，稳步突破，充分发挥商业落地产业链能力
拥抱智算时代下的全面国产化浪潮**



谢谢!

苏州盛科通信股份有限公司